

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-032

**合肥芯碁微电子装备股份有限公司**  
**2024 年度“提质增效重回报”行动方案**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，积极响应上海证券交易所关于沪市公司积极开展提质增效重回报专项行动号召倡议，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，实现管理层与股东利益的共担共享，合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年度“提质增效重回报”行动方案，具体措施如下：

**一、聚焦做强主业，提升经营质效，以良好的业绩成长回报投资者**

1、**聚焦主赛道，开发新产品、开拓新领域，技术赋能 AI 时代**  
作为国内直写光刻设备领军企业，近年来公司不断提升 PCB 曝光设备性能，设备功能从线路层曝光扩展至阻焊层曝光，全面覆盖 PCB 各细分产品市场。同时不断推出用于 IC 掩模版制版、IC 载板、先进

封装、新能源光伏、新型显示等细分领域的泛半导体直写光刻设备，成长空间得到不断拓展。

在 PCB 领域，受益于大算力时代，产品升级&出口双轮驱动，2024 年，公司将紧握行业升级及国产替代趋势，从研发和扩产两个维度加强 PCB 设备的产品升级，推动多层板、HDI 板、柔性板以及 IC 载板等中高端 PCB 产品市场份额占比不断提升，同步加大高端阻焊市场的 NEX 系列直写光刻设备的扩产。

出口链方面，公司已提前部署了全球化海外策略，2024 年公司将加大东南亚地区的市场布局，目前已完成泰国子公司的设立登记，今年将积极建设海外销售及运维团队，发挥自身品牌、技术开发和市场营销的优势，增强海外客户的服务能力。

在泛半导体领域，2024 年公司持续多赛道拓展，丰富产品矩阵丰富，推进直写光刻技术应用拓展不断深化。IC 载板方面，目前解析度达  $4\mu\text{m}$  的载板设备 MAS4 已发至客户端验证，2024 年公司将持续加大对 IC 载板新品的研发，加速产能扩充和性能提升；先进封装方面，公司自主研发的晶圆级封装设备 WLP2000 各项性能指标已达到国际先进水平，公司将加快提升封装设备产能效率，以满足在更高算力的大面积芯片上的曝光环节适配有更高的产能效率和成品率；掩膜版制版方面，公司首台满足量产 90nm 节点制版需求的掩膜板制版设备已在客户端验证，今年公司也将推进 90nm-65nm 制版光刻设备的研究进程，以满足半导体掩膜版技术的更新迭代；新型显示方面，公司设备在解决 Mini/micro-LED 的芯片、基板制造及利用 RDL 再布线技术解决巨量转移问题均有较好的优势。2024 年公司将紧跟显示领域的市场需求发展趋势，为新型显示领域内的应用创造广阔空间；新能

源光伏方面，公司将积极推动直写光刻设备在光伏领域的产品开发及产业化验证力度，在 HJT/Topcon /XBC 等新型太阳能电池技术应用领域中不断发展。同时，会配合下游市场需求提供解决图形一体化方案，充分把握市场先机。

此外，作为技术创新驱动型公司，2024 年公司将推进前沿技术研发，加快新品开发，紧握多重行业机遇。在 SEMICON CHINA 2024 展会上，公司推出了键合制程解决方案，展出了新品 WA 8 晶圆对准机与 WB 8 晶圆键合机，这两款设备均为半导体加工过程中的关键设备。WA 8 晶圆对准机是一款操作便捷、灵活性高、能够实现模块化升级的高精度晶圆对准设备，适用于 4、6、8 英寸晶圆。该设备可用于先进封装、MEMS 生产和需要亚微米级精确对准的应用场景；WB 8 晶圆键合机能够实现所有类型的键合，如阳极键合、热压键合等。支持最大晶圆尺寸为 8 英寸，采用半自动化操作，可运用于先进封装、MEMS 等多种应用。该设备采用了上下对称的快速加热和冷却系统，并配备高性能施压系统，从而确保键合工艺的高效完成。同时，2024 年公司也将推进先进封装所需要的量测、曝光、检测的技术路线图，期待与半导体产业界客户进行更紧密的合作。

## **2、优化运营管理，完善内控体系**

公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、物料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等众多方面。公司定期跟踪各项指标的执行情况，严抓产品质量，并根据统计结果和客户反馈，制定出关键指标的改进要求。公司建立了高效的库存管控体系，设置合理的库存警戒线，以加快存货周转。2024 年，公司将以经营数字化、运行

信息化、管理标准化为支撑，全面推行企业“数智化”转型，推动信息优化企业运营流程。在内控体系方面，公司将提升人员营运效率，缩短设备交付周期，并努力保持 100%订单准时交付。随着公司发展规模的不断扩张，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系，促进公司高速、稳定、健康发展。

### **3、加强技术及产品开发流程，完善研发平台，强化知识产权管理**

2024 年，公司将全面优化 IPD 体系，建立覆盖产品全周期的产品开发管理体系，坚持以客户需求为导向，完善市场调研、技术评估、产品立项、产品开发、试制及中试、量产等全流程评审决策机制，确保产品开发与客户需求对齐；调整和完善研发组织架构和 workflows，实现技术开发与产品开发的分工与协同，实现技术资源有效配置；进一步完善 PLM 研发管理信息化系统，提升研发效率，加强研发管理；持续推进知识产权保护，加强核心技术专利的系统布局，为公司的下一步发展奠定基础。

### **4、全力推进国际化，激活高质量发展新动能**

为了更好地满足未来经营计划和发展战略的需要，深度融入核心客户全球供应链体系，快速响应海外客户需求，提升行业竞争力和海外市场占有率，2024 年公司将全力全速推进国际化战略，从国际化的市场思维、国际化经营模式落实市场发展。公司将根据市场的需求，加大东南亚地区的市场建设，同步辐射日韩市场，拓宽公司的全球市场覆盖范围，提升品牌影响力，培养一支具备国际视野和跨文化沟通

能力的专业团队，增强在国际市场上的竞争力，激活公司高质量发展的新动能。

## **二、持续完善公司治理，防范风险并提升规范运作水平**

### **1、完善内控建设，加强内部审计和风险控制**

2024 年，公司将持续完善内控建设，结合公司实际情况，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新，持续提升公司的内部控制管理体系。公司将完善风险预警和应对机制，定期开展内部审计和风险评估，确保公司稳健运营和合规经营。

### **2、深化公司治理、强化“关键少数”责任**

2024 年，公司将根据新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，持续完善法人治理结构，提高规范运作水平，积极响应独立董事制度改革精神，加快落实独立董事制度改革等要求；不断加强公司治理能力建设，强化大股东、董监高等“关键少数”合规意识，切实推动公司高质量发展。

## **三、坚定落实股东回报计划**

### **1、持续实施现金分红**

公司重视对投资者的合理投资回报，在《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》中对公司利润分配的原则、分配形式、现金分红条件和比例、利润分配的决策和实施程序等均作出了明确的规定。公司在上市次年即实施了 2021 年度利润分配方案，保护广大投资者的合法权益。2023 年度，综合考虑投资者的回报需求和公司的长远发展，

公司以总股本 131,419,086 股扣除回购股份 477,322 股后的股份数量 130,941,764 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金红利 104,753,411.20 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 58.42%，全体股东共享公司发展红利。

2024 年，公司将继续按照法律法规以及《公司章程》等关于现金分红的规定，保证公司长远发展的前提下，匹配好资本开支、经营性资金需求，结合公司未分配利润及资金情况，为投资者提供连续、稳定的现金分红，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。同时，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索更多方式方法回报股东，提升广大投资者的获得感。

## 2、实施股份回购

基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司健康可持续发展，公司实际控制人、董事长程卓女士提议公司通过集中竞价交易方式进行股份回购，公司于 2024 年 2 月 24 日发布了回购股份方案的公告，拟以人民币 3,000 万元~6,000 万元（含）的资金总额回购公司股份，截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 477,322 股，占公司总股本 131,419,086 股的比例为 0.3632%，支付的资金总额为人民币 30,016,900.65 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

2024 年，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定

及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机进行回购，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

#### **四、高质量信息披露，积极传递公司投资价值**

公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。2024年，公司将继续通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司将举办不少于三次的业绩说明会。投资者热线、邮件及上证e互动问题必须回复，仔细解答投资者的相关问题。

#### **五、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象**

公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务，专注主营业务，提升公司的核心竞争力、努力通过良好的业绩表现，规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2024年6月27日